证券代码: 300666 证券简称: 江丰电子

债券代码: 123123 债券简称: 江丰转债

## 宁波江丰电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号: 2022-005

投资者关系 活动类别	<ul><li>■特定对象调</li><li>□媒体采访</li><li>□新闻发布会</li><li>□现场参观</li><li>■其他 (电量</li></ul>	□□	↑析师会议 2绩说明会 }演活动	
	单位名称	姓名	单位名称	姓名
	浙商证券	蒋高振	建信基金	尹润泉
参与单位名称及	浙商证券	叶有为	建信基金	邱宇航
人员姓名	建信基金	姜锋	建信基金	李梦媛
	建信基金	王东杰	建信基金	郭帅彤
	建信基金	刘克飞	建信基金	李峰
时间	2022年2月17日			
地点	公司会议室			
上市公司 接待人员姓名	董事兼总经理 JIE PAN、董事兼财务总监于泳群、证券事务代表施雨虹			

投资者通过电话会议的方式与公司相关人员进行问答交流,具体内容如下:

1、铜靶和钨靶今年在客户端的进展情况如何?

回复:经过长时间的研发,公司已经解决铜及铜合金靶和钨靶的技术难点,产品已经在客户端评价。

2、公司如何从半导体靶材领域拓展到零部件领域?

回复:近年来,全球半导体市场规模不断扩大,下游市场需求持续高涨。我国半导体产业也处于加速发展的阶段, 国产替代需求较为迫切。

投资者关系活动

半导体零部件是半导体设备的关键构成,半导体零部件和半导体靶材的制造工艺有异曲同工之处,且拥有相似的客户群体。公司深耕溅射靶材行业十七年,建立了由数十位海外归国人才、数百位自主培养人才组成的核心团队,具备了扎实的专业知识储备和丰富的生产实践经验,构建了较强的技术壁垒和商业护城河,并与国内外知名主流厂商建立了较为稳定的合作关系,深受客户信赖与喜爱。同时,公司具备强大的核心竞争力,包括金属加工能力、表面处理能力、服务于半导体行业的精细化管理能力和客户应对能力,能够为客户提供优质的产品与高效的技术支持。

因此,公司不仅专注于主营业务的发展,还充分整合资源、技术、市场等多方优势,前瞻布局半导体零部件领域,争取通过横向拓展零部件等新兴产品领域,优化产品结构,进一步拓展公司业务范围,完善业务布局,从而开启新一轮的成长周期。未来,公司将继续以奋斗者为本,以客户为中心,持续为半导体产业奋斗,努力成为"世界一流的半导体材料企业"。

3、未来三年,公司业绩增长看点体现在哪方面?

回复:近年来,半导体下游应用领域不断扩展和快速发展,溅射靶材的市场空间随之扩容,且随着信息技术的飞速发展,集成电路的集成度越来越高,对芯片关键材料高纯溅射靶材也提出了新的技术挑战。同时,溅射靶材行业是国家重点鼓励发展的战略性新兴产业,在政策的支持下,溅射靶材的国产替代进程不断加速。

公司持续追踪国际先进集成电路技术节点,紧跟客户发展步伐,加快产品的研发创新与批量应用。目前,公司集成电路用常规高纯金属溅射靶材亟待扩张产能。此外,公司积极通过可转债募投项目及其他投资项目在平板显示用靶材、半导体零部件、CMP等领域持续布局,全方位开拓市场,驱动公司不断提升核心竞争力、盈利能力和可持续发展能力。

## 4、公司溅射靶材的制造环节有哪些?

回复: 溅射靶材制造环节首先需要根据下游应用领域的性能需求进行工艺设计,然后进行反复的塑性变形、热处理,需要精确地控制晶粒、晶向等关键指标,再经过焊接、机械加工、清洗干燥、真空包装等工序。溅射靶材制造所涉及的工序精细且繁多,工序流程管理及制造工艺水平将直接影响到溅射靶材的质量和良品率。

## 5、公司半导体零部件的种类有哪些?

回复:公司半导体零部件种类繁多,根据应用客户可以分为两大类,一类应用于芯片生产设备制造厂商,包括工艺零部件和腔体等;另一类则是应用于集成电路制造企业的晶圆制造过程中的关键工艺零部件。公司零部件产品以金属、陶瓷类为主。

6、公司目前的产能状况如何?公司如何扩张产能? 回复:目前,公司产能总体处于饱和状态。公司通过对 生产过程实施精细化管理,建立智能生产线,不断提高生产效率。同时,公司已经开始实施可转债募投项目,即主要在广东惠州和武汉建设平板显示用靶材及部件生产基地,从而进一步扩大平板显示用高纯金属溅射靶材及相关机台部件的生产能力。

此外,为了突破半导体靶材产能瓶颈,扩大生产能力及规模优势,公司本次向特定对象发行股票拟在浙江余姚及海宁建设超大规模集成电路用高纯金属全系列靶材的生产线,进一步扩大公司集成电路用高纯铝靶材、高纯钛靶材及环件、高纯钽靶材及环件、高纯铜及铜合金靶材及环件、铜阳极等主要产品规模化生产能力。公司本次向特定对象发行股票项目的方案尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册批复后方可实施。

附件清单(如有) 无

日期

2022年2月17日